



美光专为 NVIDIA Vera Rubin 打造的 HBM4 进入大规模量产阶段, PCIe 6.0 SSD 与 SOCAMM2 同步量产

March 17, 2026 at 10:00 AM CST

新闻亮点:

- 美光 12 层堆叠 36GB HBM4 大规模量产: 专为 NVIDIA® Vera Rubin 平台设计, 带宽超过 2.8TB/s^[1], 能效提升 20%^[2]
- 业界首款 PCIe® 6.0 SSD 大规模量产^[3]: 美光 9650 数据中心 SSD 读取性能最高可达上一代 PCIe 5.0 的两倍, 每瓦性能提升 100%^[4], 并针对 NVIDIA BlueField-4 STX 架构上的智能体 AI 工作负载进行优化
- 192GB SOCAMM2 大规模量产: 专为 NVIDIA Vera Rubin 平台设计, 为 AI 及 HPC 工作负载提供低功耗、高容量的内存解决方案。该产品隶属于美光丰富的 SOCAMM2 产品线, 容量覆盖 48GB 至 256GB。

2026 年 3 月 17 日, 加利福尼亚州圣何塞 —GTC 2026— 面向 AI 优化的内存与存储已成为提升系统性能的战略资产, 助力 AI 工作负载及基础架构实现实际价值。美光科技股份有限公司 (纳斯达克股票代码: MU) 宣布, 专为 NVIDIA Vera Rubin 打造的 12 层堆叠 36GB HBM4 已于 2026 年第一季度开始量产出货。美光 HBM4 的引脚速率超过 11 Gb/s^[5], 带宽突破 2.8 TB/s, 相较于 HBM3E, 带宽提升 2.3 倍, 能效提升超 20%²。

在进一步扩大 HBM 存储立方体容量方面, 美光已向客户送样 16 层堆叠 48GB HBM4, 展示了 16 层 HBM 晶粒堆叠的先进封装能力。这一里程碑成果使 HBM 单颗搭载容量较 12 层堆叠 36GB HBM4 提升 33%^[6]。

美光科技执行副总裁兼首席商务官 Sumit Sadana 表示: “下一个阶段的 AI, 将由生态系统协同工程创新所打造的深度集成平台来定义。美光与 NVIDIA 的紧密合作, 确保了计算与内存从设计之初就能实现协同扩展。这一切的核心, 正是作为 AI 引擎的美光 HBM4, 它带来了前所未有的带宽、容量与能效。随着 12 层堆叠 36GB HBM4、业界首款 SOCAMM2 与 PCIe 6.0 SSD 的大规模量产, 美光的内存与存储产品形成了核心基石, 充分激发下一代 AI 的无限潜能。”

美光 SOCAMM2 专为 NVIDIA Vera Rubin NVL72 系统及独立 [NVIDIA Vera CPU](#) 平台设计, 每颗 CPU 可支持高达 2TB 内存及 1.2TB/s 带宽。

美光是业界首家实现 PCIe 6.0 数据中心 SSD 量产的厂商³。美光 9650 SSD 针对能效与液冷环境进行优化, 借助 NVIDIA BlueField-4 STX 参考架构, 为 AI 训练及推理工作负载提供高速、低延迟的数据访问能力, 其顺序读取吞吐量可达 28GB/s, 随机读取 IOPS 高达 550 万次。此外, 美光 7600 SSD 及 9550 SSD 同时为客户提供 PCIe 5.0 方案, 进一步丰富其架构设计选择。

美光将于 2026 NVIDIA GTC 展示创新成果

在 2026 年 NVIDIA GTC 大会上, 美光将展示其先进内存与存储产品组合, 如何助力实现从数据中心到端侧的端到端 AI 加速。参会者可前往美光 1407 号展位了解详细信息。

更多资源:

- [美光 AI 数据中心解决方案网页](#)
- [美光 HBM4 产品图库](#)
- [美光 9650 PCIe 6.0 产品图库](#)
- [美光博客: From breakthrough demo to deployment path: SCADA on production-grade PCIe Gen6 hardware at NVIDIA GTC 2026](#)

关于 Micron Technology Inc. (美光科技股份有限公司)

美光科技是创新内存和存储解决方案的业界领导厂商, 通过改变世界使用信息的方式来丰富全人类生活。我们始终以客户为中心, 专注引领技术创新, 追求卓越制造与运营, 向客户交付丰富的高性能内存和存储产品组合

——包括 DRAM、NAND 及 NOR。美光团队打造的创新产品，每一天都助力数据经济的发展，推动人工智能（AI）和计算密集型应用的突破，释放从数据中心到本地智能设备的无限机遇。如需了解 Micron Technology Inc.（美光科技股份有限公司，纳斯达克股票代码：MU）的更多信息，请访问 micron.cn

© 2026 Micron Technology Inc.（美光科技股份有限公司）保留所有权利。信息、产品和/或规格如有变更，恕不另行通知。Micron、Micron 徽标和所有其他 Micron 商标均为 Micron Technology Inc.（美光科技股份有限公司）所属商标。所有其他商标分别为其各自所有者所有。

美光媒体联络人

高诚公关

潘平 / 美光服务团队

电话：+86 188 8388 2632

E-mail: ppan@golin.com

[1] 在容量与堆叠层数相同（12 层堆叠 36GB）的条件下，对比 HBM4 与上一代 HBM3E 的带宽。

[2] HBM 能效对比：在 9.2 Gbps 速率下，采用 60/30/10/75 工作负载模式，对比 12 层 HBM4 与 12 层 HBM3E 的能效 [数据源自内部功耗计算工具]。

[3] 2026 年 2 月 12 日，美光宣布 9650 SSD 正式量产。截至本新闻稿发布时，根据 Forward Insights 于 2025 年 11 月发布的《2025 年第四季度 SSD 供应商状况》（SSD Supplier Status Q4/25）分析报告，按营收计全球排名前五的 OEM 数据中心 SSD 供应商中，尚未有其他厂商宣布其 PCIe 6.0 SSD 量产。

[4] 关于美光 9650 SSD 的性能测试结果，请参阅 [Micron 9650 SSD Product Brief](#) 中的表 1。

[5] 基于美光内部测试及机密客户测试芯片验证结果。

[6] 对比 12 层 36GB HBM4，16 层 48GB HBM4 的 HBM 单颗搭载容量提升 33%。